

ものづくり技術研究会

支援先

金属加工企業等

【目的】

機械加工や形状測定、強度測定等のセミナー活動を通して、中小企業の技術力向上の一助となることを目指し、平成 26 年度よりものづくり技術に関する研究会活動を進めております。

【内容】



図 1 第 1 回研究会の様子
(デモ機によるサンプル測定)

有識者による関連技術の講演、保有設備を使用したデモンストレーションを行いました。

○第 1 回ものづくり技術研究会「日立 SEM セミナー」(座学)
平成 28 年 7 月 21 日 (参加者: 43 名)
講師 (株)日立ハイテクノロジーズ 塩野正道氏 他

○第 2 回ものづくり技術研究会「観察・分析のための試料作製方法」(座学+実習)
平成 28 年 10 月 25~26 日 (参加者: 19 名)
講師 ビューラーITW ジャパン(株) 川本洋氏



図 2 第 2 回研究会の様子
(切断実習中)

○第 3 回ものづくり技術研究会「切削基礎セミナー」(座学)
平成 28 年 12 月 7 日 (参加者: 39 名)
講師 サンドビック(株) 内海義之氏

第 1 回研究会では、電子顕微鏡の基本原則から観察テクニックなど分かりやすく教えていただきました。また、SEM の特性を交えながら最新のトピックス (工業分野だけでなく、医療農業分野での観察事例など) も紹介いただきました。参加者からは、前処理コーティングの厚みについてなど具体的な質問が多く、普段疑問に感じていることの解決に役立てていただきました。

第 2 回研究会では、観察・分析のための試料作製方法の大まかな流れ (切断・埋込・研磨) と、各工程における一般的な注意点について教えていただきました。IC チップのような断面観察試料作製の難しい試料では、研磨前処理の切断・埋め込みが重要とのことでした。実習希望者が多く、研磨観察の必要性を感じている企業が多いことがわかりました。

第 3 回研究会では、切削性の話や工具摩耗対策、工具選定時に考慮すべき項目など、切削全般について講義いただきました。実際に現場で加工に携わっている方々にとって、経験的知識の裏付けになったのではないかと思います。



図 3 第 3 回研究会の様子

基礎となった事業

平成 28 年度 オンリーワン技術開発支援事業 (研究会)

現在の担当部門

先端材料部門

部 門 長 浅野 俊之
主任研究員 行武 栄太郎
主 任 早乙女 秀丸
主 任 上田 聖
主 任 石川 裕理
技 師 吉岡 健

TEL:029-293-7492